

中電流離子佈植機

考核項目清單

※ 事前檢驗

檢查使用記錄相關表單.....★

※ 系統簡介

簡介此系統(基本原理、面板控制、機台三大區塊、主要參數及影響...等).....★

三大區塊中各主要機構簡介：

Source 如何運作★

Beam Line 包含哪些機構，簡述運作原理(Analyzer、Faraday Cup...等).....★

End Station 機構簡述(Loadlock、Target Chamber、Faraday Cup、Platen...等).....

※ 系統操作使用

系統登入.....

System Start up(每天第一次使用時).....★

手動模式調機：

Load & Unload Wafers 操作★

Recipe 選擇與設定★

手動調 Beam，各項參數解釋與調校：

Source 部份，ARC 點電漿各項參數(氣體、電壓、磁場、加熱燈絲...等)..★

萃取電壓(X、Y、Z 軸調整).....★

Beam Line 調整(Analyzer、Q1、Q2、Deflector、Acc/Dec...等).....★

佈植時，各項監控狀態是否在合理範圍.....

佈植完畢，收件與關閉相關機構(ARC 相關、Extract、Acc/Dec 模組、氣體...等).....★

Sign Off.....

※ 其他

運轉期間，Inter Lock 處置方式.....